

SMT 88U 超快速固化胶水说明书 产品数据表

出色的可靠性
优秀的低温固化性能
易返修

简介

SMT 88U 是一种集合了紫外光快速固化胶水和低成本毛细管底部填充胶优点的胶水。它可以在室温下不对基板预热就可以进行底部填充。固化后的 SMT 88U 很容易返修。SMT 88U 不仅可以被用做 CSP、BGA、POP、LGA 和一些倒装芯片的底部填充剂;它还适合用做裸芯片的保护,例如内存卡、芯片载体、混合电路和混装芯片模块。SMT 88U 无环境污染,适合大批量生产,生产效率高且抗机械振动能力强。这种材料是易点胶水、热应力小,能提供可控制的粘合厚度及出色的可靠性(比如:温度循环性能)。跌落性能的表现比使用锡膏高出两个数量级。

物理特性

产品名称	SMT 88U 粘胶剂
固化前材料性能	
外观	灰色
比重 (ASTM D 1475-60)	1.08 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	300-500 cp
毛细管流动速度 (STM 777)	室温底部填充
固化后材料性能	
玻璃化转变温度 (Tg)	69 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	$\alpha 1 = 75$; $\alpha 2 = 182$
搭接剪切强度(FR4/FR4)	2000 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化条件

SMT 88U 可以在几秒内固化,推荐固化条件如下:

88°C 2分

120°C 8秒

150°C 1秒

(注意:固化时间不包括升温时间,可适应其他温度曲线)

储存与保质期

密封保存于-25°C的环境下,产品保质期为6个月。若超过保质期产品粘度会变高。应防潮、防蒸发和污染物,蒸发或污染会影响产品性能。

安全信息

SMT 88U 是一种环保无毒材料,我们建议采用普通生产防护方法处理该产品。详情请查阅我们的 产品安全数据表。

包装规格

SMT 88U 有 5 cc, 10 cc 和 30 cc,也可根据客户要求提供其他包装方式。请联系英 凯公司了解更多订购信息。